

技術詞彙表

本詞彙表載有本文件所用與本公司及其業務有關的若干詞彙的解釋。本詞彙表所載術語及其涵義未必與該等詞彙的標準行業涵義或用法一致。

「AC」	指	交流電，一種週期性地反轉方向並隨時間連續改變其大小的電流，而直流電僅單向流動；
「放大器」	指	一種可增加信號功率的電子設備。其為一種雙埠電子電路，使用來自電源供應器的電力來增加施加到其輸入端信號的振幅（電壓或電流的幅度），從而在其輸出端產生成比例的更大振幅信號；
「應用編程接口」	指	應用編程接口，一種使不同應用程序能夠互通的方法；
「芯片電性測試」	指	一種對芯片的電氣參數進行的測試，對晶圓中的每個芯片進行測試以去除有缺陷的部件，從而降低後續封裝的成本；
「電路驗證」	指	一種驗證電路正確性、評估及確認初步設計方案並確保設計滿足下游客戶的需求及符合設計方案的方式；
「CoB」	指	板上芯片封裝，一種電路板製造方式，其將IC（如微處理器）連接（有線、直接連接）到印刷電路板上，並用環氧樹脂覆蓋；
「比較儀」	指	一種將模擬電壓信號與基準電壓進行比較的裝置，一般具有高或低兩種狀態的單端輸出，可以對信號進行比較和判斷。與放大器相比，比較儀的頻率特性有限，但延遲時間很短且帶有滯回電路；
「DC」	指	直流電，電荷的單向流動；

技術詞彙表

「DFN」	指	雙扁平無引腳封裝，一種小型方形或矩形表面貼裝無引腳塑料封裝，接近芯片級封裝，具有低剖面、適中散熱性能及良好電氣性能；
「晶粒」	指	一小塊半導體材料，在其上製造出給定的功能電路；
「EDA」	指	電子設計自動化，一類用於設計電子系統(如IC和印刷電路板)的軟件工具。這些工具在芯片設計人員用於設計和分析整個半導體芯片的設計流程中協同工作；
「電氣化」	指	用電力提供動力的過程，多數情況下，電力從另一種能源轉換而來；
「fabless」	指	設計和銷售硬件設備和半導體芯片，同時將其製造服務外包給稱為半導體代工廠的專業製造商；
「代工廠」	指	生產金屬鑄件的加工廠；
「IDM」	指	集成設備製造商，一家負責設計、製造、封裝、測試和後續銷售成品的公司；
「集成電路」或「IC」	指	一個小單元或封裝，其被製成單個不可分割的結構(如芯片)，在電氣上相當於由許多獨立元件組成的傳統電路；
「物聯網」	指	嵌入傳感器、處理能力、軟件和其他技術的物理對象(或物理對象組合)，可以通過互聯網或其他通信網絡與其他設備和系統建立連接並交換數據；
「IP」或「IP模塊」	指	知識產權，就IC設計而言，指具有定義功能的可複用及經驗證IC版圖設計；

技術詞彙表

「LCD」	指	液晶顯示器，一種平板顯示器或其他電子調製光學設備，使用液晶的光調製特性與偏振器相結合；
「LED」	指	發光二極管，一種半導體二極管，當施加電壓時會發光；
「鋰」	指	一種金屬化學元素，其元素符號為Li；
「微控制器單元」	指	通常用於指定應用並設計用於完成若干任務的單一IC。其包含一個或多個CPU（處理器核心）以及存儲器及可編程輸入／輸出外設；
「摩爾定律」	指	一種觀測結果，即IC中可容納的晶體管數量約每兩年增加一倍，其以戈登•摩爾的名字命名；
「ODM」	指	原設計製造商，一家設計和製造產品的公司，其產品最終被另一家公司重新命名出售；
「OLED」	指	有機發光二極管，一種發光二極管，其放射性電致發光塗層為一層有機化合物薄膜，通過電流發光；
「OSAT」	指	外包半導體組裝與測試，一家提供第三方IC封裝測試服務的公司。該公司為代工廠製造的硅器件提供封裝，並在投放市場之前對器件進行測試；
「圖案晶圓」	指	附有內置電路的晶圓，其於出售時未經封裝。一個圖案晶圓包含多個晶粒，經下游客戶後續封裝測試後，該等晶粒能夠輕易變成芯片；
「電源管理IC」	指	電源管理集成電路，一種執行各種電源相關必備功能的IC。電源管理IC通常用於為小型設備和電池供電設備供電，因為將多種功能集成到單個芯片中可提高空間利用率和系統電源效率；

技術詞彙表

「信號鏈」	指	按順序接收輸入（從實時圖像或存儲數據採樣中獲取的數據）的一系列信號調節電子元件，信號鏈的一部分輸出為下一部分提供輸入；
「SiP」	指	系統級封裝，將多個IC封裝在一個或多個芯片載體封裝中，可以使用堆棧式封裝堆疊；
「SoC」	指	片上系統，一種集成計算機或其他電子系統的大部分或所有組件的IC。這些組件基本都包括片上中央處理器、內存接口、輸入或輸出設備、輸入或輸出接口以及輔助存儲器接口，通常與無線電調製解調器和圖形處理單位等其他組件一起使用；
「SOP」	指	小引出線封裝，一種表面貼裝IC封裝，其佔用面積較等效雙列直插式封裝小約30-50%，標準厚度少70%；
「SOT」	指	小外形晶體管，一系列小尺寸、分立式表面貼裝晶體管，通常用於消費電子；
「拓撲結構」	指	電路元件的互連網絡所採取的一種形式。元件的不同特定值或額定值被視為是相同的拓撲結構；
「晶圓」	指	用於製造IC的半導體薄片，如晶體硅(c-Si)；及
「晶圓渠道合作夥伴」	指	一家為IC設計公司提供IC產品生產管理服務的公司。